

Apple планирует оснастить iPhone 2027 года совершенно новой технологией памяти, что сделает устройство мощнее, умнее и, вероятно, значительно дороже. Юбилейный смартфон, приуроченный к 20-летию линейки, должен получить поддержку продвинутой памяти HBM, ранее использовавшейся в серверах и системах искусственного интеллекта.

Речь идет о типе памяти с высокой пропускной способностью, где чипы располагаются вертикально и соединяются через специальные сквозные переходы — TSV. Такая архитектура позволяет передавать данные быстрее и эффективнее по сравнению с традиционными решениями, при этом потребляя меньше энергии.

Эта технология, хоть и разрабатывалась в первую очередь для серверов, теперь адаптируется для мобильных устройств. Благодаря ей Apple сможет запускать крупные модели ИИ прямо на смартфоне — без подключения к облаку. Это даст прирост скорости, снизит задержки и нагрузку на аккумулятор.

Внедрение HBM также позволит уменьшить размеры компонентов, что может повлиять на общий дизайн — устройства станут тоньше, а внутри освободится больше места для других элементов.

Поставщиками новой памяти для Apple выступают южнокорейские Samsung и SK Hynix. Каждая компания применяет собственный подход к упаковке чипов — у Samsung это метод VCS, а у SK Hynix — VFO. Массовое производство планируют начать в 2026 году.

Однако, по словам источников, технология остается дорогой, и это может привести к росту цен на iPhone 2027 года.